

深圳联宏达电子材料有限公司

电话：0755-23315767 传真：0755-23315737
地址：深圳市宝安区沙井新桥第三工业区金元二路 25 号

T500 系列导热硅胶-材质说明

T500 系列 导热硅胶是填充发热器件和散热片或金属底座之间的空气间隙，它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个 PCB 传导到金属外壳或扩散板上，从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。

产品特性：

- 》良好的热传导率:5.0W/mK
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

产品应用：

- 》散热器底部或框架
- 》LED 液晶显示屏背光管
- 》LED 电视 LED 灯具
- 》高速硬盘驱动器
- 》RDRAM 内存模块
- 》微型热管散热器
- 》汽车发动机控制装置
- 》通讯硬件
- 》便携式电子装置
- 》半导体自动试验设备

T500 系列特性表				
颜色	灰	Visual	厚度	热阻@10psi (°C-in²/W)
结构&成分	陶瓷填充 硅橡胶	***	10mils / 0.254 mm	0.21
			20mils / 0.508 mm	0.27
比重	2.65 g /cc	ASTM D297	30mils / 0.762 mm	0.39
			40mils / 1.016 mm	0.43
热容积	1 l /g-K	ASTM C351	50mils / 1.270 mm	0.50
			60mils / 1.524 mm	0.58
硬度	45 Shore 00	ASTM 2240	70mils / 1.778 mm	0.65
			80mils / 2.032 mm	0.76
抗张强度	35 ps	ASTM D412	90mils / 2.286 mm	0.85
			100mils / 2.540 mm	0.94
使用温度范围	-50 to 200℃	***	110mils / 2.794 mm	1.00
			120mils / 3.048 mm	1.07
总质量损失(TML)	0.45%	ASTM E595	130mils / 3.302mm	1.16
			140mils / 3.556 mm	1.25
介电常数	10.2 MHz	ASTM D150	150mils / 3.810 mm	1.31
			160mils / 4.064 mm	1.38
体积电阻率	5.0X10" Ohm-meter	ASTM D257	170mils / 4.318 mm	1.43
			180mils / 4.572 mm	1.50
防火等级	94 V0	equivalent UL	190mils / 4.826 mm	1.60
			200mils / 5.080 mm	1.72
导热率	5.0W/m-K	ASTM D5470	Visua l/ ASTM D751	ASTM D5470